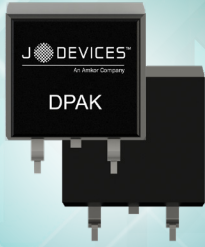


DPAK (TO-252)

DPAK은 JEDEC 표준을 준수하는 중전력 Power discrete 제품입니다.



Features

- ▶ Si 와이어 본딩에 의한 낮은 온 저항 및 높은 전류 밀도
- ▶ 웨이퍼 프로브부터 테스트와 패키징까지 완벽한 턴키 서비스
- ▶ 무연 도금

Under Development

- ▶ 친환경 칩 어태치 무연 슬더
- ▶ 할로겐 프리 몰드 소재

Process Highlights

- ▶ 인터커넥트 : 두꺼운 Si 와이어 본딩 기술
- ▶ 도금 : 100% matte Sn
- ▶ 마킹 : 레이저 마크

Applications

DPAK은 낮은 온 저항 및 고속 스위칭 MOSFET 용으로 설계된 중전력 애플리케이션(기준치 80W*/60A)에 적합한 패키지입니다.

적합한 분야 :

- ▶ 모터 드라이버
- ▶ 전원 공급 회로
- ▶ DC-DC 컨버터
- ▶ 소비자 가전 제품
- ▶ 자동차 용 제품

*Tc = 25°C, Tj = Max 150°C

Reliability Qualification

제이디바이스의 패키지는 신뢰성이 입증된 반도체 재료로 제조됩니다.

- ▶ 고온방치(HTS)를 제외한 모든 신뢰성 테스트는 JEDEC 표준 전처리 요구사항을 포함합니다.
- ▶ 85°C/85%RH, 168 hours, IR reflow 260°C 3X
- ▶ PCT: 121°C/100% RH/2 atm, 96 hours
- ▶ 온도 사이클 : -65°C/+150°C, 300 cycles
- ▶ 고온방치(HTS) : 150°C, 1000 hours

Test Service

제이디바이스는 MOSFET, 지능형 전원 장치 등 다양한 Power discrete 테스트를 포함한 전체 턴키 솔루션을 제공합니다.

- ▶ Power discrete 테스트 :
 - ▷ DC
 - ▷ Capacitance *1
 - ▷ Rg *1
 - ▷ Avalanche test
 - ▷ 열 저항
- ▶ 프로그램 변환
- ▶ 전기적 불량 분석
- ▶ 통합 테스트, 마킹, 육안 검사와 테이프 릴 서비스

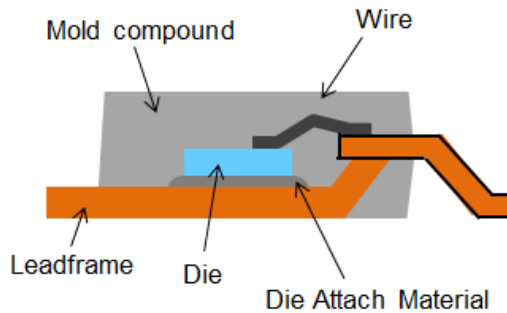
*1 샘플링 테스트에 한함

DPAK (TO-252)

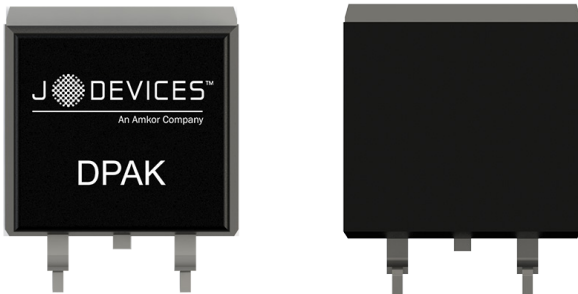
Standard Materials

- ▶ 리드프레임 : Cu (와이어 본딩 영역에 Ni 도금)
- ▶ 칩 어태치 : Pb solder
- ▶ 인터커넥트 : Al 와이어, 최대 11.8 mil
- ▶ 몰드 수지 : 할로겐

Cross-section



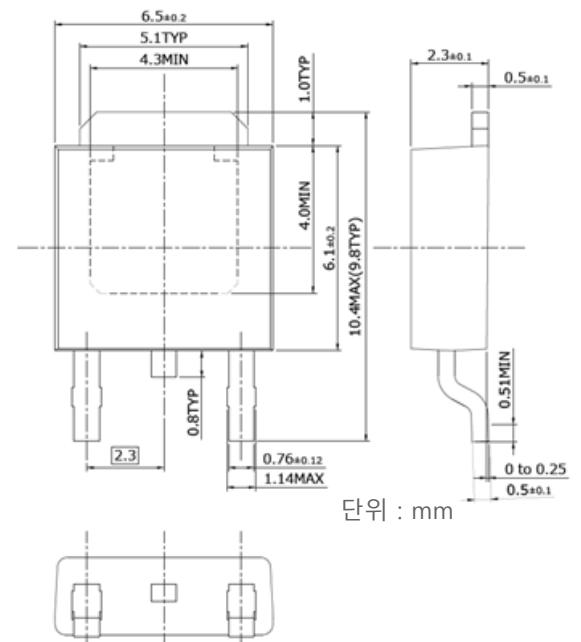
Top & Bottom View



Shipping

- ▶ 테이프 및 릴 포장
 - ▷ 릴 당 2000개
 - ▷ 테이프 넓이 : 10.7 mm
 - ▷ 릴 $\Phi = 330$ mm
- ▶ 바코드 패키징 라벨

Package Outline Drawing



자세한 내용은 amkor.com을 방문하거나 ATKQnA@amkor.co.kr로 이메일을 보내십시오.

본 문서의 모든 콘텐츠는 저작권법에 따라 무단복제 및 배포를 금지하며, 제공된 정보의 정확성을 보장하지 않습니다. 앰코는 본 문서의 정보사용에 따른 특허나 라이선스 등과 관련된 어떠한 형태의 피해에 대해서도 책임을 지지 않습니다. 본 문서는 앰코의 제품보증과 관련하여 표준판매약관에 명시된 것 이상으로 확대하거나 변경하지 않습니다. 앰코는 사전고지 없이 수시로 제품 및 제품정보를 변경할 수 있습니다. 앰코의 이름 및 로고는 Amkor Technology, Inc.의 등록상표입니다. 그 외 언급된 모든 상표는 각 해당 회사의 자산입니다. © 2018, Amkor Technology Incorporated. All Rights Reserved. DSJD414B Rev Date: 10/18